深圳市龙图光罩股份有限公司

公司代码:688721　　公司简称:龙图光罩

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险因素,敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中关于风险因素的内容。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是√否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。以上利润分配预案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	龙图光罩	688721	/

1.2 公司存托凭证简况

□适用√不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓少华	李建宗
联系地址	深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园4#厂房101	深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园4#厂房101
电话	0755-23207580	0755-23207580
传真	0755-29480739	0755-29480739
电子信箱	ir@starmask.net	ir@starmask.net

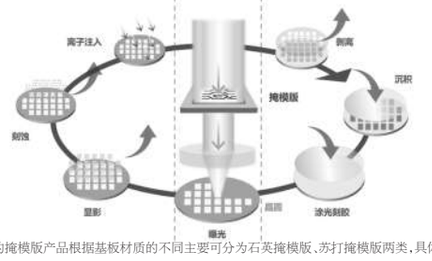
2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

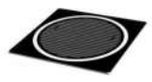
公司主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售,是国内稀缺的独立第三方半导体掩模版厂商。公司紧跟国内半导体发展路线,不断进行技术攻关和产品迭代,量产产品对应下游晶圆制造的工艺节点已提升至90nm,更高节点产品已在送样验证和规划建设中。公司掩模版产品广泛应用于信号链及电源管理IC等成熟制程,以及功率器件、MEMS 传感器、先进封装等特色工艺制程。

公司主要产品为掩模版,掩模版也称光罩,是集成电路制造过程中的图形转移工具或者母版,承载着图形信息和工艺技术信息,广泛应用于半导体、平板显示、电路板、触控屏等领域。掩模版的作用是将承载的电路图形通过曝光的方式转移到硅晶圆等基体材料上,从而实现集成电路的批量化生产。

掩模版在半导体生产中的应用



公司生产的掩模版产品根据基板材质的不同主要可分为石英掩模版、苏打掩模版两类,具体图示和介绍如下:

产品名称	产品图例	产品简介	应用场景
石英掩模版		以高纯石英玻璃为基材,具有高透过率、高平坦度、低膨胀系数等优点,成本较高,通常应用于高精度掩模版产品。	主要用于对精度要求高的功率半导体、模拟芯片、逻辑芯片等领域。
苏打掩模版		使用苏打玻璃作为基板材料,热膨胀率相对高于石英玻璃,平整度和耐磨性相对弱于石英玻璃,成本相对较低,主要用于中低精度掩模版。	主要用于对精度要求较低的中低端半导体制造、半导体封装、光学器件、触控屏和电路板制造等领域。

2.2 主要经营模式

(1)盈利模式

公司主营业务为掩模版的研发、生产和销售,根据下游客户定制化的需要,设计和生产掩模版。公司产品主要应用于半导体领域,凭借良好的客户需求转换能力、制程能力、品质保证能力、技术服务能力等不断开拓行业内大客户,持续获取订单,实现产品销售并获得盈利。

(2)研发模式

公司始终坚持自主研发和技术创新,建立了涵盖新产品开发、工艺研发、CAM软件开发、设备研发的研发体系。公司建立了《研发与知识产权内部控制制度》,规范了从项目立项、项目实施与验收的全流程。公司始终致力于探索、改进掩模版的工艺制造流程,提升产品良率,提高生产制造效率,同时对于掩模版生产所需的部分设备进行了研发、改进,从工艺到设备多角度提升掩模版产品性能。

(3)采购模式

公司采购物料主要分为主料与辅料,其中主料包括制作掩模版所需要的石英基板、苏打基板以及光学膜,辅料主要为在显影刻蚀环节用到的显影刻蚀材料,以及ABS包装盒等。公司主要采取"以销定采"的方式,同时对于通用性较强的原材料,如石英基板、苏打基板、光学膜等,根据销售预测、库存情况及原材料市场供应情况适当备货。

(4)销售模式

公司的主要产品具有显著定制化特征,主要采用直销模式,同时存在少量代理商销售收入,其协助公司开拓及维护中国台湾地区客户。公司依据客户对产品的规格工艺要求,通过产品成本加合理毛利并结合市场竞争情况等确定销售价格。

(5)生产模式

由于掩模版为定制化产品,产品需要根据客户的个性化需求进行定制化设计与生产,因此,公司采取"以销定产"的生产模式,即根据销售订单安排生产。公司拥有包含CAM板图处理、光刻、显影、刻蚀、清洗与检测等掩模版全环节自主生产能力,凭借丰富的行业经验和领先的技术水平能够快捷高效为客户提供高质量产品与服务。

2.3 所处行业情况

1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

受全球经济格局深度调整、地缘政治博弈持续交织影响,2025年全球半导体行业在产业格局重构中保持强劲上行态势,行业发展呈现分化与机遇并存的多元特征。半导体行业作为现代高科技产业与战略性新兴产业的核心基石,是数字经济、高端制造、信息技术、通信产业等领域发展的核心支撑,产业战略地位持续凸显。近年来,人工智能大模型(AI)、高性能计算(HPC)、智能网联汽车、新能源、工业物联网、5G-A通信等新兴领域迎来爆发式增长,驱动半导体芯片需求结构持续升级,推动全球晶圆制造产能稳步扩张,进而带动半导体材料市场规模的持续扩容。

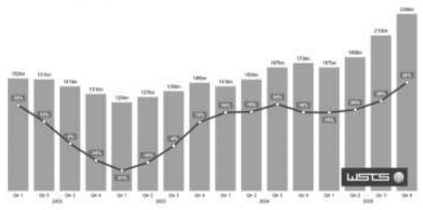
从国内市场来看,在全球产业链加速重构、贸易保护主义持续抬头的背景下,叠加产业政策的持续支持,国内半导体产业自主可控进程全面深化,在特色工艺、成熟制程、先进封装等关键领域实现多项技术与产品突破,国内晶圆制造产能稳步释放,带动半导体材料、设备等上游产业链的国产替代进程加速向纵深推进,为国内具备核心技术与产能优势的半导体掩模版企业持续提供良好的发展环境。

半导体掩模版生产厂商可以分为晶圆厂自建配套工厂和独立第三方掩模厂商两大类。由于28nm以下的先进制程晶圆制造工艺复杂,其配套掩模版涉及晶圆制造厂的重要工艺机密,因此先进制程晶圆厂所用的掩模版大部分由自己的内部工厂生产,如英特尔、三星、台积电、中芯国际等。对于28nm及以上等较为成熟的制程所用的掩模版,芯片制造厂商为了降低成本,在满足技术要求下,更倾向于向独立第三方掩模版厂商进行采购。

半导体掩模版在晶圆制造的光刻工艺中需要经由的图形特征尺寸小、精度高,配套的掩模版复杂度多,且随着半导体工艺的不断提升,掩模版的要求也越来越苛刻,因此半导体掩模版对最小线宽、位置精度、CD 精度、缺陷管控等均提出了很高的要求,工艺难度大,技术壁垒高。半导体掩模版在晶圆制造中的关键作用及制作难度决定了半导体掩模版供应商必须具备较大的资本投入、较强的工艺水平、精度控制能力以及完善的技术研发体系,才能满足不断升级的半导体制造的苛刻要求。

(1)半导体市场:迎来强劲增发,AI与存储带动趋势显著

根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)发布的2025年全年半导体市场业绩报告数据显示,2025年全球半导体销售额达到7,956亿美元,同比增长26.2%,且根据WSTS和SIA最新预测,全球半导体销售预计将在2026年持续增长,行业规模将接近1万亿美元大关。



数据来源:WSTS

(2)晶圆制造:全球晶圆产能扩张,先进制程提速,成熟制程稳步增长

据SEMI数据研报,2025年全球新建晶圆厂预计有18座,包括15座12英寸晶圆厂和3座8英寸晶圆厂,其中12英寸晶圆聚焦先进制程,服务于AI芯片、高性能计算、手机SoC等高端需求;8英寸产线瞄准汽车电子、工业控制、电源管理、物联网等成熟制程市场,缓解长期产能紧缺问题。

从地域分布来看,2025年全球新建晶圆厂中中国大陆占了3座,项目集中于成熟制程领域,主要服务于汽车芯片、工业控制等内需市场,预计2027年中国成熟制程产能在全球的占比将升至47%,成为全球最大成熟制程基地。从制程结构来看,2025年预计全球先进制程节点(7nm及以下)的月产能将达到220万片等效8寸晶圆,同比增长16%;主流制程节点(8~45nm)的月产能将达到1,500万片等效8寸晶圆,同比增长6%;成熟制程节点(45nm以上)的月产能预计将达到1,400万片等效8寸晶圆,同比增长5%。

晶圆产能扩张带来光刻环节频次增加,使得掩模版作为消耗品的需求持续放大,叠加不同制程对掩模版规格、技术参数的差异化需求,进一步丰富了掩模版的产品结构,推动掩模版行业整体需求持续向好。

(3)掩模版:半导体材料市场快速增长,设计产业扩张联动

半导体材料是产业的基石,其市场规模与下游技术演进紧密联动。根据TECHCET的预测,到2028年全球半导体材料市场规模将超过840亿美元。同时,制造更先进技术节点的逻辑芯片、3D存储芯片及异构集成技术需要更多的工艺步骤,直接推高了晶圆制造材料的消耗需求。掩模版作为第三大晶圆制造材料,将受益于此轮结构性增长。从区域格局看,SEMI报告显示,亚太地区(包括中国、中国台湾、韩国等)占据全球掩模版市场40%~45%的核心份额。区域内晶圆厂的持续扩产是拉动掩模版需求的根本力量。中国大陆半导体材料市场增速显著高于全球平均水平,这主要得益于国内晶圆产能的快速扩张与国产替代进程的加速。SEMI预计,2025年中国半导体材料市场有望达到200亿美元。因此从半导体材料市场的整体扩容与亚太地区的核心地位看,本土掩模版的市场空间将持续快速增长。

另从需求前端的角度看,芯片设计行业的发展亦为掩模版需求提供了直接驱动力。根据中国半导体行业协会集成电路设计分会显示的数据,2025年中国芯片设计产业销售额预计达8,357.3亿元,同比增长29.4%,展现出强劲增长势头。从数量上看,2025年国内设计企业已增至3,901家,其中年销售额超1亿元的企业达831家。芯片设计公司数量及其销售额的增长意味着NTO数量的增长,每个NTO对应着一套全新的掩模版,NTO项目的数量增长与掩模版需求量呈正相关关系。

2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

2025年,半导体光罩行业迎来国产替代深化、竞争格局动态调整的关键阶段,外资厂商在大陆市场份额亦受到国产替代显著影响。公司作为国内半导体光罩领域核心参与者,在细分产品市场形成了自身的竞争优势;在BIM产品市场,公司是行业核心参与方之一,凭借稳定的产品品质、及时的交付能力与良好的客户关系占据重要市场地位;在65nm以上PSM产品市场,亦具备了为客户提供相关产品及服务的综合能力。

公司聚焦半导体光罩主业,是国内为数不多的主营半导体光罩的独立第三方厂商,长期与华虹宏力、士兰微、立昂微、英诺赛科等国内主要晶圆厂保持合作,在功率半导体、MEMS、第三代半导体等特色工艺光罩领域形成较强客户黏性,成为下游客户国产化采购的重要选择之一。

2025年,在行业格局深度调整背景下,公司在技术能力与市场拓展方面取得了稳步进展;技术制程方面,公司持续深耕成熟制程,90nm产品已成功实现量产,逐步间高端制程领域迈进;在客户合作方面,公司产品与服务覆盖了国内多家主流晶圆厂。凭借稳定的产品品质和及时的交付响应,公司与核心客户的合作关系不断深化,在国产化进程加速的行业背景下,市场认可度得到进一步提升。

在第三方半导体掩模版市场,公司将充分受益于国产替代带来的市场机会,同时也将面临头部企业向下渗透、行业同质化竞争加剧的挑战。目前中国大陆第三方光罩市场,境内厂商与境外厂商的技术差距主要体现在特色工艺,成熟制程与先进制程几个层次:

①在特色工艺制程领域,对于130nm 及以上制程节点的半导体掩模版,以公司为代表的境内厂商工艺技术水平已经达到国际一线竞争对手同等水平,产品关键参数无明显差异,性能水平基本相当,产品进入国产替代后期,国产厂商竞争开始显现;

②对于130nm~28nm制程节点的成熟制程半导体掩模版产品,该领域是包括公司在内的当前境内第三方厂商技术攻关和产品研发的主要方向,目前与国际一线厂商各个环节上尚存在一定差距,但是短期内技术追赶存在较大的可能;

③对于28nm以下的先进制程节点的半导体掩模版,由于境外掩模版厂商具有资本投入的先发优势和产业链集群优势,同时中国大陆半导体行业受贸易制裁、出口管制等因素影响,目前我国境内第三方掩模版厂商暂时无法涉及28nm以下制程节点的先进制程掩模制造,仅有极少数头部晶圆厂具备相应制版技术。

公司不断增加投入进行技术攻关和产品迭代,产品广泛应用于信号链及电源管理IC等成熟制程,以及功率器件、MEMS传感器、先进封装等特色工艺制程。目前珠海工厂90nm PSM产品已实现量产,65nm产品已开始送样验证,并已完成40nm 工艺节点的生产设备布局,多项工艺优化技术已应用于现有生产线,预计2026年相关研发成果将持续转化为营收增长点。公司与国内重点的晶圆厂及设计公司均建立了深度的合作关系,技术实力及工艺能力在国内独立第三方半导体掩模版厂商中处于第一梯队。

3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况

2025年,全球科技革命与产业变革向纵深演进,新质生产力加速赋能实体经济,集成电路作为信息产业的核心底座与全球科技竞争的战略制高点,相关新技术、新产业、新业态、新模式迎来新的发展。人工智能领域技术迭代与商业化落地全面提速,多模态通用大模型、端侧轻量化大模型、生成式AI实现全行业深度渗透,具身智能技术实现核心环节突破,人形机器人产业进入商业化试点与量产爬坡的关键阶段,带动全球算力需求呈指数级增长,重构了半导体芯片的需求结构。

半导体制程迭代逼近物理极限,以CoWoS为代表的 2.5D/3D 异构集成技术成为突破算力瓶颈的核心路径,Chiplet 芯粒技术标准化进程持续加快,与硅通孔(TSV)、重布线层(RDL)、扇出型封装等技术深度融合,先进封装产业进入高速发展期。AI算力爆发驱动高速光互联需求激增,800G/1.6T/3.2T高速光模块渗透率快速提升,以台积电硅光工艺平台为代表的硅光技术持续迭代,硅光芯片与CMOS逻辑芯片的异构集成实现规模化量产,全球硅光产业进入产业化全面提速阶段。

以碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)为核心的第三代半导体材料实现 8 英寸大尺寸规模化量产,车规级功率器件在新能源汽车、储能、智能电网等领域的渗透率持续提升,氧化镓、金刚石等超宽禁带半导体前瞻研发取得一定突破。与此同时,产业发展新业态新模式持续涌现,AI大模型深度融入半导体设计、制造、检测全流程,产业链上下游协同创新、联合研发的生态系统持续完善,定制化全流程解决方案成为行业核心发展方向。

第二代半导体产业的规模化扩张与前瞻技术布局,持续拉动掩模版的市场需求,是行业持续稳定增长的重要动力。产业链协同创新的新业态新模式,推动掩模版企业与集成电路设计、制造、封测上下游企业深度合作,为国产掩模版企业深化进口替代、提升市场份额带来了持续发展机遇。

(2)半导体掩模版行业发展趋势

①随着半导体技术节点的进步,半导体掩模版最小线宽及精度要求不断提升

半导体产品随着工艺技术进步和性能提升,线宽越来越窄,对上游掩模版的工艺水平和精度控制能力提出了更高要求。为了解决掩模版制作过程中由于线宽逐步缩小带来的诸多难题,以OPC光学邻近效应修正技术、PSM相移掩模版技术、电子束光刻技术为代表的一系列图形分辨率增强技术兴起并快速发展。

②芯片层数增加导致掩模版的张数增加,数据处理和套刻精度控制要求更高

随着终端产品的功能日趋复杂,半导体产品的集成度持续提高,晶圆制造的工艺不断进步。随着芯片堆叠层数的增加,半导体器件与集成电路的电路图也越发复杂,晶圆表面需要光刻的图案由传统的二维电路图像发展成含有多层结构的三维电路图像,这也导致半导体掩模版的张数不断增加,CAM版图处理的难度进一步加大,掩模版的套刻精度控制也更加困难。

③特色工艺半导体快速发展,对掩模版定制化要求越来越高

近年来随着新能源汽车、光伏发电、自动驾驶、新一代移动通信、人工智能等新技术的不断成熟,特色工艺半导体行业发展迅速。特色工艺不完全依赖缩小晶体管特征尺寸,而是聚焦于新材料、新结构、新器件的研发创新与运用,强调定制化和技术品类多元性。由于下游特色工艺半导体高度定制化、平台繁多、种类庞杂、领域众多,且通常会集成多种功能,这对于第三方掩模版厂商的定制化服务能力提出了更高的要求,掩模版厂商需要有足够的技术储备才能满足快速发展的特色工艺半导体的定制化要求。

④先进封装技术将成为行业增长的重要引擎,封装用掩模版迎来重要发展期

以CoWoS为代表的2.5D/3D异构集成技术将持续迭代,Chiplet技术的标准化与规模化应用加速,先进封装与 HBM 高带宽内存、硅光技术的融合将进一步深化,直接带动先进封装专用掩模版需求持续爆发,成为行业重要的增长极。

⑤新兴技术有望赋能企业优化生产经营管理

AI技术和应用有望对半导体掩模版设计、制造、检测、服务全流程进行优化提升,在光学邻近校正、CAM版图处理比对、纳米级缺陷智能识别、生产工艺持续优化、机台资源调度等环节实现初步应用,有效提升研发效率、生产良率,产品可靠性与快速响应能力。

与此同时,产业链上下游协同创新的发展模式将持续深化,掩模版企业与集成电路设计、晶圆制造、先进封测企业的绑定将更加紧密,通过联合技术攻关、工艺平台共建、验证资源共享的模式,加速国产化产业链的协同适配与技术突破,推动进口替代向纵深发展。

⑥凭借规模和技术专业化优势,独立第三方掩模版厂商市场份额增加

半导体掩模版行业具有显著的资本投入大、技术壁垒高、高度依赖专有技术的特点。晶圆制造厂商自行配套掩模工厂,主要是出于信息保密和制作能力的考量。随着制程工艺逐渐成熟及第三方掩模版厂商的制作水平的不断提升,自建掩模工厂的诸多不足逐渐体现,如设备、人工投入巨大,生产环节复杂,成本昂贵等。第三方半导体掩模版厂商能充分发挥技术专业化、规模化优势,具有显著的规模经济效应,在技术水平、产品性能指标符合要求前提下,独立第三方掩模版厂商对晶圆制造厂商的吸引力不断增加。

此外,由于掩模版承载着芯片设计方案和图形信息,涉及到芯片设计公司的重要知识产权,第三方半导体掩模版厂商作为芯片设计与芯片制造的中间桥梁,能够更好地发挥信息隔离功能,芯片设计公司更倾向于将芯片设计版图交给第三方掩模版厂商以保证自身的信息安全。总体来看,随着技术水平不断提高,第三方独立掩模版厂商竞争优势将不断体现,市场份额将持续增加。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	1,546,833,581.68	1,313,154,265.85	17.80	631,586,182.24
归属于上市公司股东的净资产	1,211,911,159.17	1,203,865,425.06	0.67	553,243,259.26
营业收入	246,658,302.88	246,503,467.92	0.06	218,292,698.54
利润总额	57,637,393.08	102,009,994.51	-43.50	95,260,821.25
归属于上市公司股东的净利润	56,088,527.42	91,832,934.36	-38.92	83,608,662.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,295,887.78	90,359,606.47	-39.91	81,786,730.18
经营活动产生的现金流量净额	80,270,177.17	109,234,813.58	-26.52	101,478,132.25
加权平均净资产收益率(%)	4.66	11.68	减少7.02个百分点	16.35
基本每股收益(元/股)	0.42	0.83	-49.40	0.84
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.83	-49.40	0.84
研发投入占营业收入的比例(%)	11.10	9.35	增加1.75个百分点	9.24

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

项目	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	54,367,405.98	61,549,345.17	67,337,262.23	63,404,289.50
归属于上市公司股东的净利润	17,333,901.54	17,730,527.66	16,724,595.21	4,299,503.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,603,991.99	17,473,749.31	16,370,129.04	3,848,017.44
经营活动产生的现金流量净额	3,307,407.36	26,898,974.87	13,207,547.17	36,856,247.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	8,492
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,793
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
叶小龙		26,366,670	19.75	26,366,670	无	0	境内自然人
柯汉奇		26,366,670	19.75	26,366,670	无	0	境内自然人
张道谷		19,586,700	14.67	19,586,700	无	0	境内自然人
深圳同创锦绣资产管理有限公司-深圳南海成长海科私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)		4,882,500	3.66		无	0	境内非国有法人
上海国方私募基金管理有限公司-上海华虹虹芯私募基金合伙企业(有限合伙)	-163,653	4,336,347	3.25		无	0	境内非国有法人
深圳市奇龙谷投资合伙企业(有限合伙)		3,766,680	2.82	3,766,680	无	0	境内非国有法人
厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业(有限合伙)	-1,832,862	3,049,638	2.28		无	0	境内非国有法人
深圳市众芯赢投资合伙企业(有限合伙)		2,259,990	1.69	2,259,990	无	0	境内非国有法人
海通创新证券投资有限公司		1,668,750	1.25	1,668,750	无	0	境内非国有法人
王日升	-1,016,490	1,243,500	0.93		无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明			(1)柯汉奇、叶小龙、张道谷之间签署《一致行动人协议》存在一致行动关系,柯汉奇为奇龙合伙执行事务合伙人。(2)除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			不适用				

存托凭证持有人情况

□适用√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

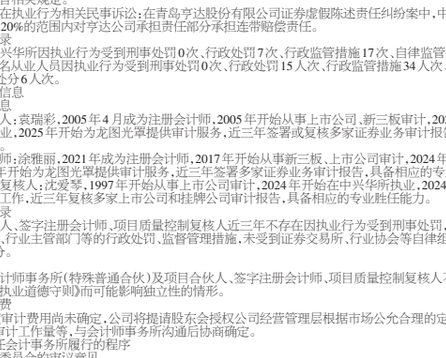
□适用√不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入24,665.83万元,较上年度增长0.06%;公司实现归属于母公司所有者的净利润5,608.85万元,较上年度下降38.92%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5,429.59万元,较上年度下降39.91%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:688721　　证券简称:龙图光罩　　公告编号:2026-011

深圳市龙图光罩股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")

一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年进行合伙制转制,转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)"

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

首席合伙人:李尊农

2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。

2024年收入总额(经审计)203,338.19万元,审计业务收入(经审计)154,719.65万元,证券业务收入(经审计)33,220.05万元。

2024年度上市公司年报审计169家,上市公司涉及的行业主要包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;房地产业;采矿业等,审计收费总额22,208.86万元。

2、投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金10,450万元,购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼:在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3、诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:袁瑞彩,2005年4月成为注册会计师,2005年开始从事上市公司、新三板审计,2024年12月开始在中兴华所执业,2025年开始为龙图光罩提供审计服务,近三年签署或复核多家证券业务审计报告,具备相应的专业胜任能力。

注册会计师:涂雅丽,2021年成为注册会计师,2017年开始从事新三板、上市公司审计,2024年开始在中兴华所执业,2024年开始为龙图光罩提供审计服务,近三年签署多家证券业务审计报告,具备相应的专业胜任能力。

质量控制复核人:沈爱琴,1997年开始从事上市公司审计,2024年开始在中兴华所执业,2024年开始为龙图光罩提供复核工作,近三年复核多家上市公司和挂牌公司审计报告,具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分。

3、独立性

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》而可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2026年度审计费用尚未确定,公司将提请股东会授权公司经营管理层根据市场公允合理的定价原则以及审计服务范围,审计工作量等,与会计师事务所沟通后协商确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的审议意见

审计委员会对中兴华的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查,在查阅了中兴华的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后,认为其具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计工作要求,此次公司续聘会计师事务所系公司实际情况和会计师审计工作安排需要,同意向公司董事会提议续聘中兴华。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年3月26日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任中兴华。

(三)生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会
2026年3月27日

证券代码:688721　　证券简称:龙图光罩　　公告编号:2026-012

深圳市龙图光罩股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市龙图光罩股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议于2026年3月26日在会议室现场召开,会议通知已于2026年3月15日以邮件、电话等合适的方式送达各位董事。本次会议应当出席董事5位,实际出席5位。

本次会议由董事长柯汉奇先生主持,高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议并通过了《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(三)审议并通过了《关于公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告的议案》

董事会认为:公司根据相关法律、法规及规范性文件等规定编制的《2025年度财务决算报告》,真实反映了公司2025年度财务状况和整体运营情况。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议并通过了《关于公司〈2025年年度报告全文及其摘要〉的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

五、审议并通过了《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

六、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度审计机构,在公司2025年度审计工作中勤勉尽责、认真履行职责,客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。因此,公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年年度审计机构,内部控制审计机构,聘期一年。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

七、审议并通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

八、审议并通过了《关于2026年度重大设备采购额度的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司2025年度利润分配预案的公告》。

十、审议并通过了《关于公司2025年度"提质增效重回报"行动方案执行情况评估报告的议案》

议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司深圳市龙图光罩股份有限公司2025年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2026年度行动方案》。

十九、审议并通过了《关于公司2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市龙图光罩股份有限公司深圳市龙图光罩股份有限公司2025年度"提质增效重回报"行动方案》。

二十、审议并通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司拟提请召开2025年年度股东会,对会议尚待提交股东会审议的议案进行审议,会议召开时间将另行通知。

议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会
2026年3月27日

证券代码:688721　　证券简称:龙图光罩　　公告编号:2026-014

深圳市龙图光罩股份有限公司
关于公司及全资子公司2026年度申请综合授信额度并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
珠海市龙图光罩科技有限公司	100,000万元(或等额外币)	25,724.34万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(